

各种规格焊锡丝装锡笔，15-20G装

产品名称	各种规格焊锡丝装锡笔，15-20G装
公司名称	常州市瑞凯泰焊材有限公司
价格	4.00/件
规格参数	型号:锡笔焊锡丝 类型:多款供选 品牌:金山阜利
公司地址	常州市新北区奔牛镇万家富1幢9号
联系电话	86-051983139559 13656126375

产品详情

型号	锡笔焊锡丝	类型	多款供选
品牌	金山阜利	助焊剂含量	2.5 (%)
标准直径	1.0 (mm)	熔点	140-320 ()
重量	50 (g)	用途	焊接材料
材质	锡合金	产地	常州
长度	10米-20米	工作温度	183
焊接电流	1	牌号	金山阜利
是否含助焊剂	是		

供应高纯度锡笔

采用高科技多组原配方生产的高级锡笔，此产品小巧、可靠、清洁、美观、残留少等特点。

焊锡笔有 4 种：

有 6 3 / 3 7 锡笔、6 0 / 4 0 锡笔、6 # 锡笔、9 # 锡笔

直径有 0.8 m / m 和 1.0 m / m

每盒内装 1 2 0 支，每箱内装 8 盒，每件内装 9 6 0 支。

小贴示

焊锡、焊锡丝、焊锡条、焊锡线、焊锡膏的用途及分类及焊锡作用

焊锡、焊锡丝、焊锡条、焊锡线、焊锡膏的用途及分类及焊锡作用。

焊料是一种熔点比被焊金属熔点低的易熔金属。焊料熔化时，在被焊金属不熔化的条件下能润湿被焊金属表面，并在接触面处形成合金层而与被焊金属连接到一起。在一般电子产品装配中，主要使用锡铅焊料，俗称为焊锡。什么是焊料焊料是一种熔点比被焊金属熔点低的易熔金属。焊料熔化时，在被焊金属不熔化的条件下能润湿被焊金属表面，并在接触面处形成合金层而与被焊金属连接到一起。在一般电子产品装配中，主要使用锡铅焊料，俗称为焊锡。

(1)常见焊锡的成分及作用 焊锡的主要作用就是把被焊物连接起来，对电路来说构成一个通路。

(2)常用焊锡具备的条件 1)焊料的熔点要低于被焊工件。

2)易于与被焊物连成一体，要具有一定的抗压能力。 3)要有较好的导电性能。 4)要有较快的结晶速度。

(3)常用焊锡的种类 根据熔点不同可分为硬焊料和软焊料；根据组成成分不同可分为锡铅焊料、银焊料、铜焊料等。在锡焊工艺中，一般使用锡铅合金焊料。 1)锡铅焊料——是常用的锡铅合金焊料，通常又称焊锡，主要由锡和铅组成，还含有铟等微量金属成分。锡铅焊料主要用途:广泛用于电子行业的软钎焊、散热器及五金等各行业波峰焊、浸焊等精密焊接。特殊焊接工艺以及喷涂、电镀等。经过特殊工艺调质精炼处理而生产成的抗氧化焊锡条,具有独特的高抗氧化性能,浮渣比普通焊料少,具有损耗少、流动性好,可焊性强、焊点均匀、光亮等特点.锡铅焊料条 锡铅焊料标准:gb/t8012-2000/gb/t3131-2001 2)共晶焊锡——是指达到共晶成分的锡铅焊料，合金成分是锡的含量为61.9%、铅的含量为38.1%。在实际应用中一般将含锡60%，含铅40%的焊锡就称为共晶焊锡。在锡和铅的合金中，除纯锡、纯铜和共晶成分是在单一温度下熔化外，其他合金都是在一个区域内熔化的，所以共晶焊锡是锡铅焊料中性能最好的一种。eutectic solders(共晶焊锡)：两种或更多的金属合金，具有最低的熔化点，当加热时，共晶合金直接从固态变到液态，而不经塑性阶段。

(4)常用焊料的形状

焊料在使用时常按规定的尺寸加工成形，有片状、块状、棒状、带状和丝状等多种。 1)丝状焊料——通常称为焊锡丝，中心包着松香助焊剂，叫松脂芯焊丝，手工烙铁锡焊时常用。松脂芯焊丝的外径通常有0.5mm、0.6mm、0.8mm、1.0mm、1.2mm、1.6mm、2.0mm、2.3mm、3.0mm等规格。

2)片状焊料——常用于硅片及其他片状焊件的焊接。 3)带状焊料——常用于自动装配的生产线上，用自动焊机从制成带状的焊料上冲切一段进行焊接，以提高生产效率。 4)焊料膏——将焊料与助焊剂粉末拌和在一起制成，焊接时先将焊料膏涂在印制电路板上，然后进行焊接，在自动贴片工艺上已经大量使用。焊接中，电烙铁的用法，松香和焊锡膏的使用

1、电烙铁安全使用用万用表欧姆档测量插头两端是否有开路短路情况，再用rx1000或rx10000档测量插头和外壳之间的电阻，如指针不动或电阻大于2-3m 就可不漏电的安全使用。

2、新电烙铁的最初使用新的电烙铁不能拿来就用，需要先在烙铁头镀上一层焊锡。具体方法是：将电烙铁烧热，待刚刚能熔化焊锡时，涂上助焊剂，再用焊锡均匀地涂在烙铁头上，使烙铁头均匀的吃上一层锡。 3、电烙铁接通电源后，不热或不太热 1)测电源如何正确使用电烙铁

焊接技术是一项无线电爱好者必须掌握的基本技术，需要多多练习才能熟练掌握。1、选用合适的焊锡，应选用焊接电子元件用的低熔点焊锡丝。

2、助焊剂，用25%的松香溶解在75%的酒精（重量比）中作为助焊剂。

3、电烙铁使用前要上锡，具体方法是：将电烙铁烧热，待刚刚能熔化焊锡时，涂上助焊剂，再用焊锡均匀地涂在烙铁头上，使烙铁头均匀的吃上一层锡。

4、焊接方法，把焊盘和元件的引脚用细砂纸打磨干净，涂上助焊剂。用烙铁头沾取适量焊锡，接触焊点，待焊点上的焊锡全部熔化并浸没元件引线头后，电烙铁头沿着元器件的引脚轻轻往上一提离开焊点。

5、焊接时间不宜过长，否则容易烫坏元件，必要时可用镊子夹住管脚帮助散热。

6、焊点应呈正弦波峰形状，表面应光亮圆滑，无锡刺，锡量适中。

7、焊接完成后，要用酒精把线路板上残余的助焊剂清洗干净，以防炭化后的助焊剂影响电路正常工作。

8、集成电路应最后焊接，电烙铁要可靠接地，或断电后利用余热焊接。或者使用集成电路专用插座，焊好插座后再把集成电路插上去。

9、电烙铁应放在烙铁架上。

松香在焊接中作为助焊剂，起助焊作用。

从理论上讲，焊剂的熔点比焊料低，起比重、黏度、表面张力都比焊料小，因此在焊接时，焊剂先融化，很快流浸、覆盖于焊料表面，起到隔绝空气防止金属表面氧化的作用，并能在焊接的高温下与焊锡及被焊金属的表面氧化膜反应，使之溶解，还原纯净的金属表面。合适的焊锡有助于焊出满意的焊点形状，并保持焊点的表面光泽。

松香是最常用的焊剂，它是中性的，不会腐蚀电路元件和烙铁头。

如果是新印制的电路板，在焊接之前要在铜箔表面涂上一层松香水。如果是已经制好的电路板，则可以直接焊接。其实松香的使用要看个人习惯，有些人是每焊接完一个元件，都会将烙铁头在松香上浸一下；我每次都是当电烙铁头被氧化，不太方便使用的时候，才会上面浸一些松香。松香的使用也很简单，打开松香盒，把通电的烙铁头在上面浸一下即可。

如果焊接时使用的是实芯焊锡，加些松香是必要的；如果使用松香锡焊丝（焊丝芯内包裹有助焊剂），可不使用松香。

由于金属表面同空气接触后都会生成一层氧化膜，温度越高，氧化越厉害。这层氧化膜阻止液态焊锡对金属的湿润作用，犹如玻璃上沾上油就会使水不能湿润一样。焊剂就是用于清除氧化膜的一种专用材料，又称助焊剂。助焊剂有三大作用：

1.除氧化膜。实质是助焊剂中的物质发生还原反应，从而除去氧化膜，反应生成物变成悬浮的渣，漂浮在焊料表面。

2.防止氧化。其熔化后，漂浮在焊料表面，形成隔离层，因而防止了焊接面的氧化。

3.减小表面张力，增加焊锡流动性，有助于焊锡湿润焊件。

焊锡膏的主要成分

大致讲来，焊锡膏的成份可分成两个大的部分，即助焊剂和焊料粉（flux & solder powder）。

（一）、助焊剂的主要成份及其作用：

- a、活化剂(activation)：该成份主要起到去除pcb铜膜焊盘表层及零件焊接部位的氧化物质的作用，同时具有降低锡、铅表面张力的功效；
- b、触变剂(thixotropic)：该成份主要是调节焊锡膏的粘度以及印刷性能，起到在印刷中防止出现拖尾、粘连等现象的作用；
- c、树脂（resins）：该成份主要起到加大锡膏粘附性，而且有保护和防止焊后pcb再度氧化的作用；该项成分对零件固定起到很重要的作用；
- d、溶剂（solvent）：该成份是焊剂组份的溶剂，在锡膏的搅拌过程中起调节均匀的作用，对焊锡膏的寿命有一定的影响；

（二）、焊料粉：

焊料粉又称锡粉主要由锡铅合金组成，一般比例为63/37；另有特殊要求时，也有在锡铅合金中添加一定量的银、铋等金属的锡粉。

焊锡的问题，不要因为一点点钱就贪便宜的买，在能承受的情况下，尽量选择无铅的焊锡，重金属对大脑没好处的。虽然业余条件很难做到，36铅64锡的共晶合金才具有最低的熔点。但是为了健康，尽力吧。反正以现在的diy条件没几样东西是我们整不到的，嘿嘿。根据自己焊接的器件来选择相应粗细的焊锡丝，晶体管电路一般用1.2mm以下直径的，电子管的电路一般使用1.2mm以上粗细的，这样焊接起来比较方便。助焊剂一般有焊锡膏和松香，个人不推荐焊锡膏，虽然它可能比较好用，但是有毒而且对pcb和元件的脚有比较强的腐蚀作用，不注意清理的话很容易伤害机器，所以还是用松香来的比较好！松香很脆，处理碎的厉害的松香的办法就是用酒精溶解，然后找个小小的容器等酒精挥发后凝固了再使用。

松香在焊接中作为助焊剂，起助焊作用。

从理论上讲，焊剂的熔点比焊料低，起比重、黏度、表面张力都比焊料小，因此在焊接时，焊剂先融化，很快流浸、覆盖于焊料表面，起到隔绝空气防止金属表面氧化的作用，并能在焊接的高温下与焊锡及被焊金属的表面氧化膜反应，使之熔解，还原纯净的金属表面。合适的焊锡有助于焊出满意的焊点形状，并保持焊点的表面光泽。

松香是最常用的焊剂，它是中性的，不会腐蚀电路元件和烙铁头。

如果是新印制的电路板，在焊接之前要在铜箔表面涂上一层松香水。如果是已经制好的电路板，则可以直接焊接。其实松香的使用要看个人习惯，有些人是每焊接完一个元件，都会将烙铁头在松香上浸一下；我每次都是当电烙铁头被氧化，不太方便使用的时候，才会上面浸一些松香。松香的使用也很简单，打开松香盒，把通电的烙铁头在上面浸一下即可。

如果焊接时使用的是实芯焊锡，加些松香是必要的；如果使用松香锡焊丝（焊丝芯内包裹有助焊剂），可不使用松香。

由于金属表面同空气接触后都会生成一层氧化膜，温度越高，氧化越厉害。这层氧化膜阻止液态焊锡对金属的湿润作用，犹如玻璃上沾上油就会使水不能湿润一样。焊剂就是用于清除氧化膜的一种专用材料，又称助焊剂。助焊剂有三大作用：

- 1.除氧化膜。实质是助焊剂中的物质发生还原反应，从而除去氧化膜，反应生成物变成悬浮的渣，漂浮在焊料表面。
- 2.防止氧化。其熔化后，漂浮在焊料表面，形成隔离层，因而防止了焊接面的氧化。
- 3.减小表面张力，增加焊锡流动性，有助于焊锡湿润焊件。

焊锡膏的主要成分

大致讲来，焊锡膏的成份可分成两个大的部分，即助焊剂和焊料粉（flux & solder powder）。

（一）、助焊剂的主要成份及其作用：

- a、活化剂(activation)：该成份主要起到去除pcb铜膜焊盘表层及零件焊接部位的氧化物质的作用，同时具有降低锡、铅表面张力的功效；
- b、触变剂(thixotropic)：该成份主要是调节焊锡膏的粘度以及印刷性能，起到在印刷中防止出现拖尾、粘连等现象的作用；
- c、树脂(resins)：该成份主要起到加大锡膏粘附性，而且有保护和防止焊后pcb再度氧化的作用；该项成分对零件固定起到很重要的作用；
- d、溶剂(solvent)：该成份是焊剂组份的溶剂，在锡膏的搅拌过程中起调节均匀的作用，对焊锡膏的寿命有一定的影响；

（二）、焊料粉：

焊料粉又称锡粉主要由锡铅合金组成，一般比例为63/37；另有特殊要求时，也有在锡铅合金中添加一定量的银、铋等金属的锡粉。

焊锡的问题，不要因为一点点钱就贪便宜的买，在能承受的情况下，尽量选择无铅的焊锡，重金属对大脑没好处的。虽然业余条件很难做到，36铅64锡的共晶合金才具有最低的熔点。但是为了健康，尽力吧。反正以现在的diy条件没几样东西是我们整不到的，嘿嘿。根据自己焊接的器件来选择相应粗细的焊锡丝，晶体管电路一般用1.2mm以下直径的，电子管的电路一般使用1.2mm以上粗细的，这样焊接起来比较方便。助焊剂一般有焊锡膏和松香，个人不推荐焊锡膏，虽然它可能比较好用，但是有毒而且对pcb和元件的脚有比较强的腐蚀作用，不注意清理的话很容易伤害机器，所以还是用松香来的比较好！松香很脆，处理碎的厉害的松香的办法就是用酒精溶解，然后找个小小的容器等酒精挥发后凝固了再使用